

# 表面処理技術から未来を創造する

## 第62期・2022年3月期 第3四半期決算説明資料

株式会社JCU

東証1部 4975



2022年2月4日(金)

# 2022年3月期3Q累計 業績概況

## 当社決算の概況

<3Q累計会計期間>

JCU(単体) → 4月 - 12月

海外子会社 → 1月 - 9月

### 《電子部品分野向け》

- 中国は、タブレットなどの高機能電子デバイス、サーバー向けプリント基板の需要が増加  
新規に獲得したラインでの稼働が本格化したことで、薬品需要は大幅に増加
- 台湾は、高機能電子デバイス、サーバー向け半導体パッケージ基板の需要が増加  
新規ラインの獲得により、薬品需要は増加
- 韓国は、半導体需要が旺盛なことを受け、半導体パッケージ基板の需要が増加  
新規ラインの獲得により、薬品需要は増加

### 《自動車分野向け》

- 国内は、半導体などの不足により、自動車産業の回復基調は鈍化傾向にあるものの、上半期までは好調に推移したことで、薬品需要は増加
- 海外は、中国において半導体などの不足により、自動車産業の回復基調は鈍化傾向にあるものの、上半期までは好調に推移したことで、薬品需要は大幅に増加

### 《装置事業》

- 自動車部品向けの設備投資は、先送り案件の再開など回復の兆しはあるものの、新規投資は慎重姿勢が継続、売上高は大幅に減少

# 2022年3月期3Q累計 連結実績

(単位：百万円)

決算期	前年同期 (2021年3月期3Q累計)	2022年3月期 3Q累計	対前年同期 増減率
売上高	15,424	17,841	15.7%
営業利益	4,951	6,626	33.8%
経常利益	4,992	6,743	35.1%
親会社株主に 帰属する 四半期純利益	3,403	4,620	35.8%
1株当たり 四半期純利益	128円66銭	176円47銭	—

# 2022年3月期 通期予想に対する進捗率

(単位：百万円)

決算期	2022年3月期 3Q累計	通期予想 (2021/11/4修正)	通期予想に 対する進捗率
売上高	17,841	23,500	75.9%
営業利益	6,626	8,300	79.8%
経常利益	6,743	8,350	80.8%
親会社株主に 帰属する 四半期純利益	4,620	5,900	78.3%
1株当たり 四半期純利益	176円47銭	225円19銭	—

# 為替レート

(単位：円)

	2021年3月期				2022年3月期			
	1Q	2Q	3Q	4Q	(期首 予想)	1Q	2Q	3Q
中国人民元 ( C N Y )	15.61	15.39	15.38	15.48	15.50	16.36	16.66	16.78
台湾ドル ( T W D )	3.62	3.61	3.62	3.63	3.60	3.77	3.84	3.88
韓国ウォン ( K R W )	0.0914	0.0898	0.0897	0.0906	0.0900	0.0951	0.0964	0.0959

(注) 当社の主要な外国通貨は、中国人民元・台湾ドル・韓国ウォンであり、いずれも、期中平均レートを採用しております。

為替感応度（連結年換算）：上記主要通貨1%の変動で、連結営業利益0.9億円程度

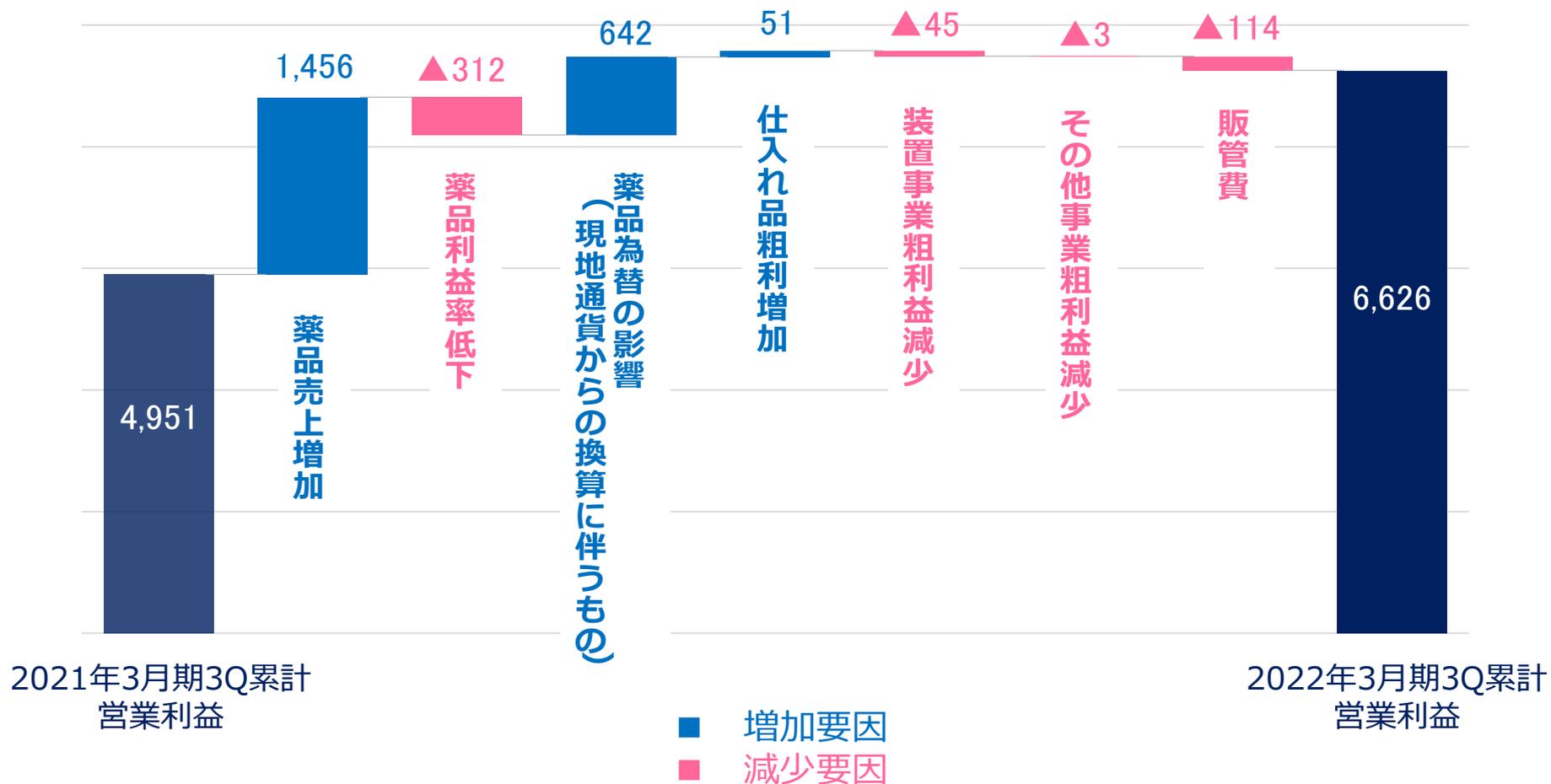
# 2022年3月期3Q累計

# 連結営業利益

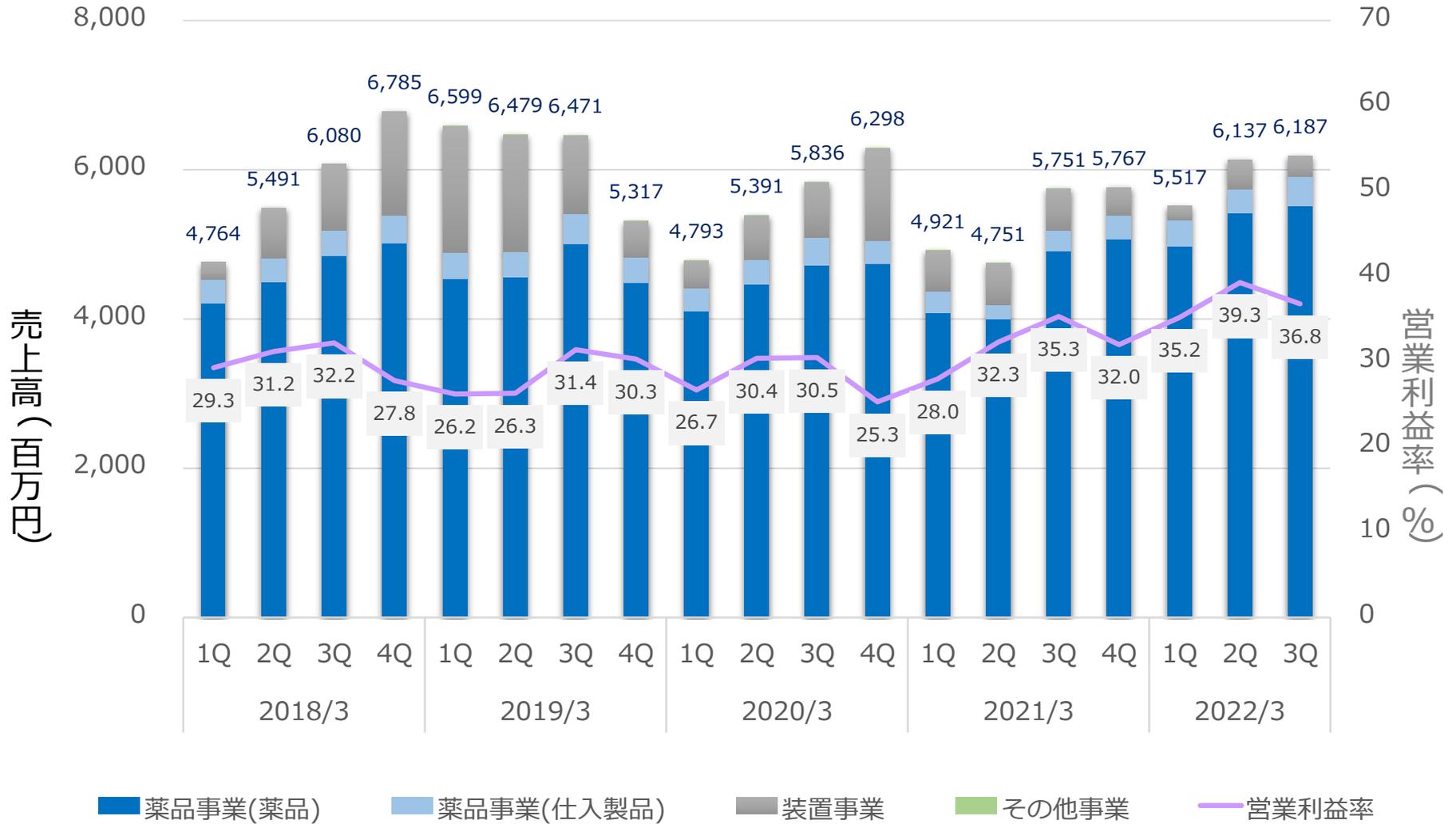
# 増減内容

(単位：百万円)

(前年同期比)  
1,675百万円増

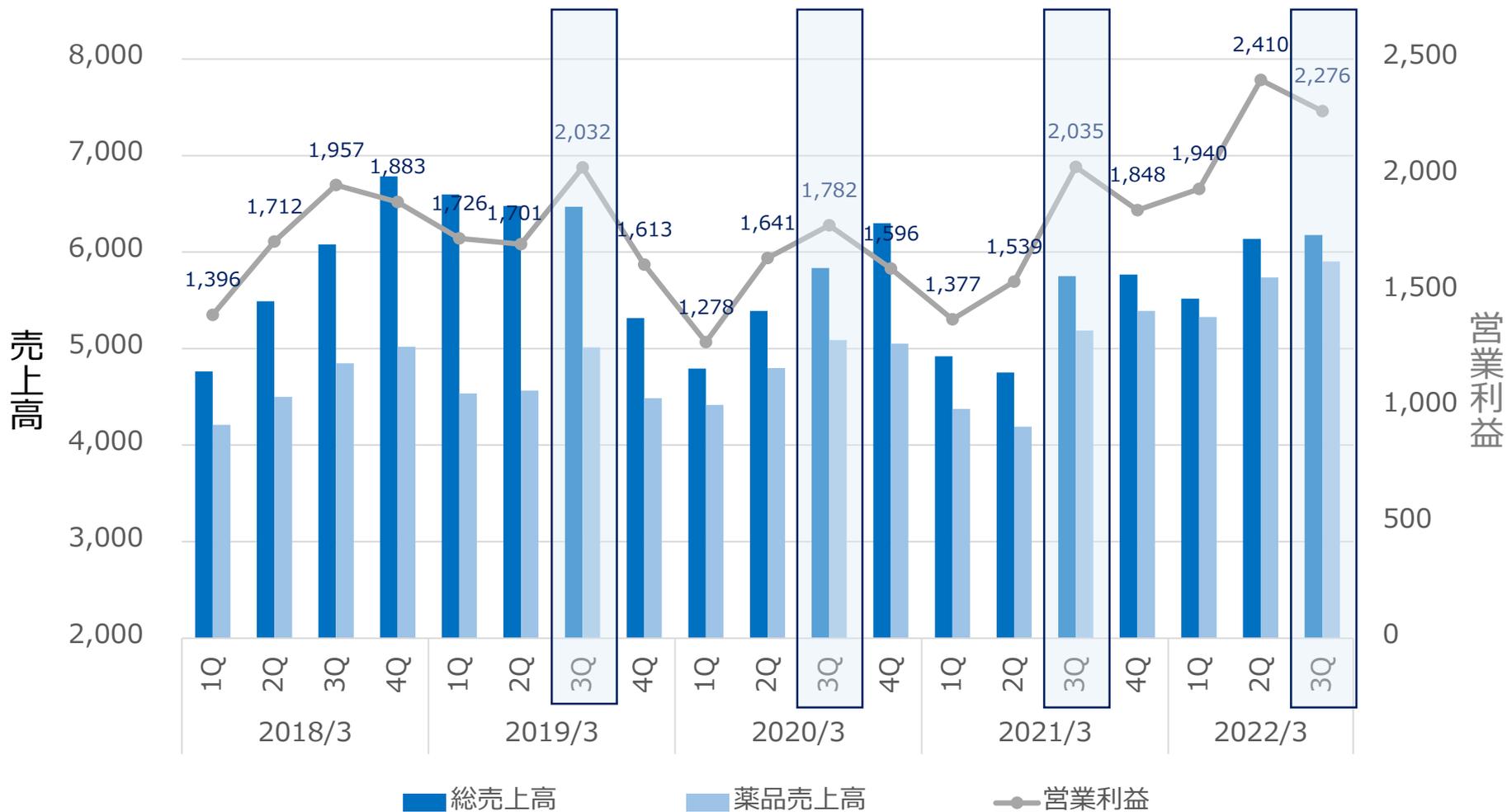


# 四半期別 連結業績の推移(セグメント別)



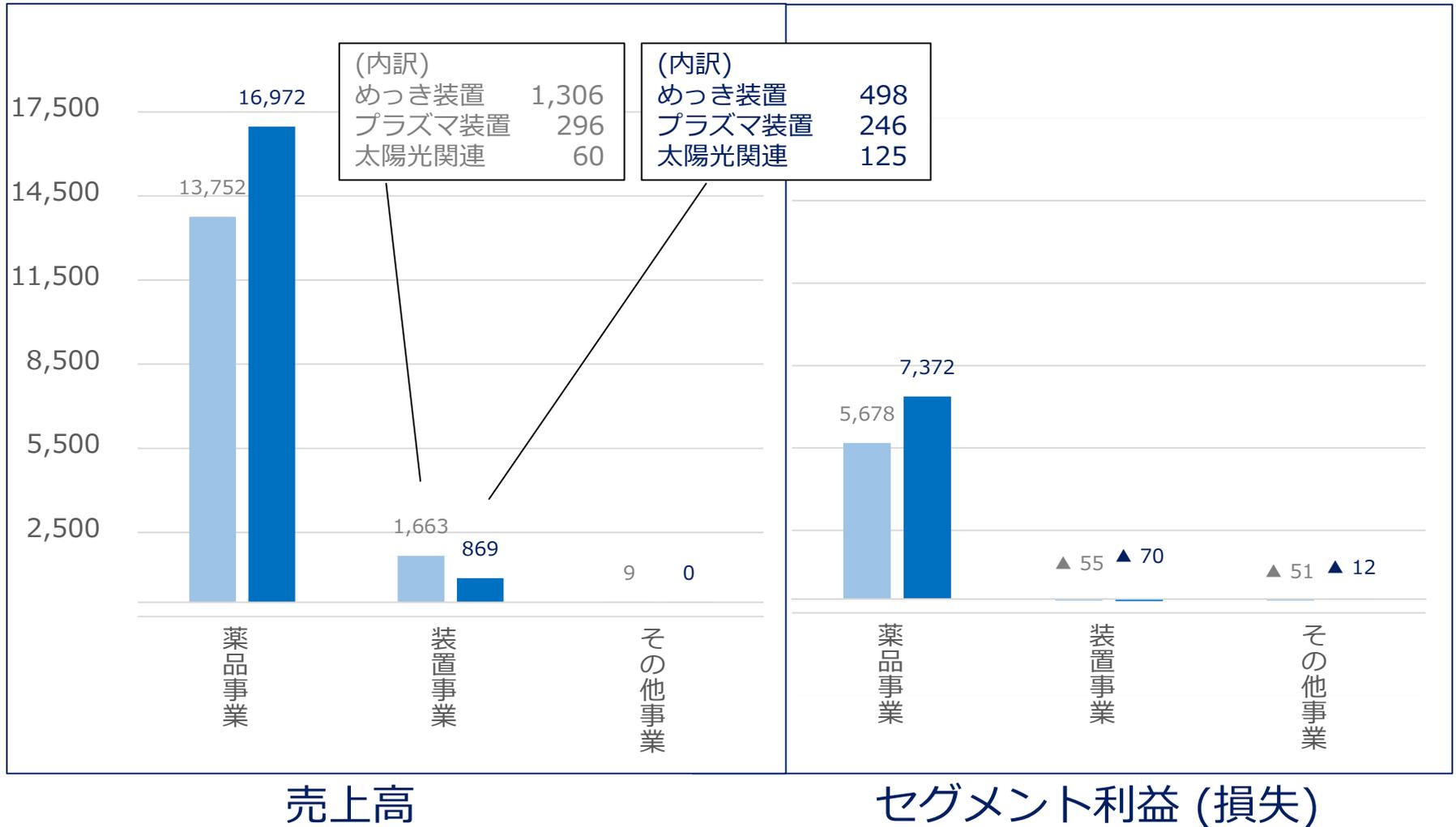
# 四半期別 連結業績の推移

(単位：百万円)



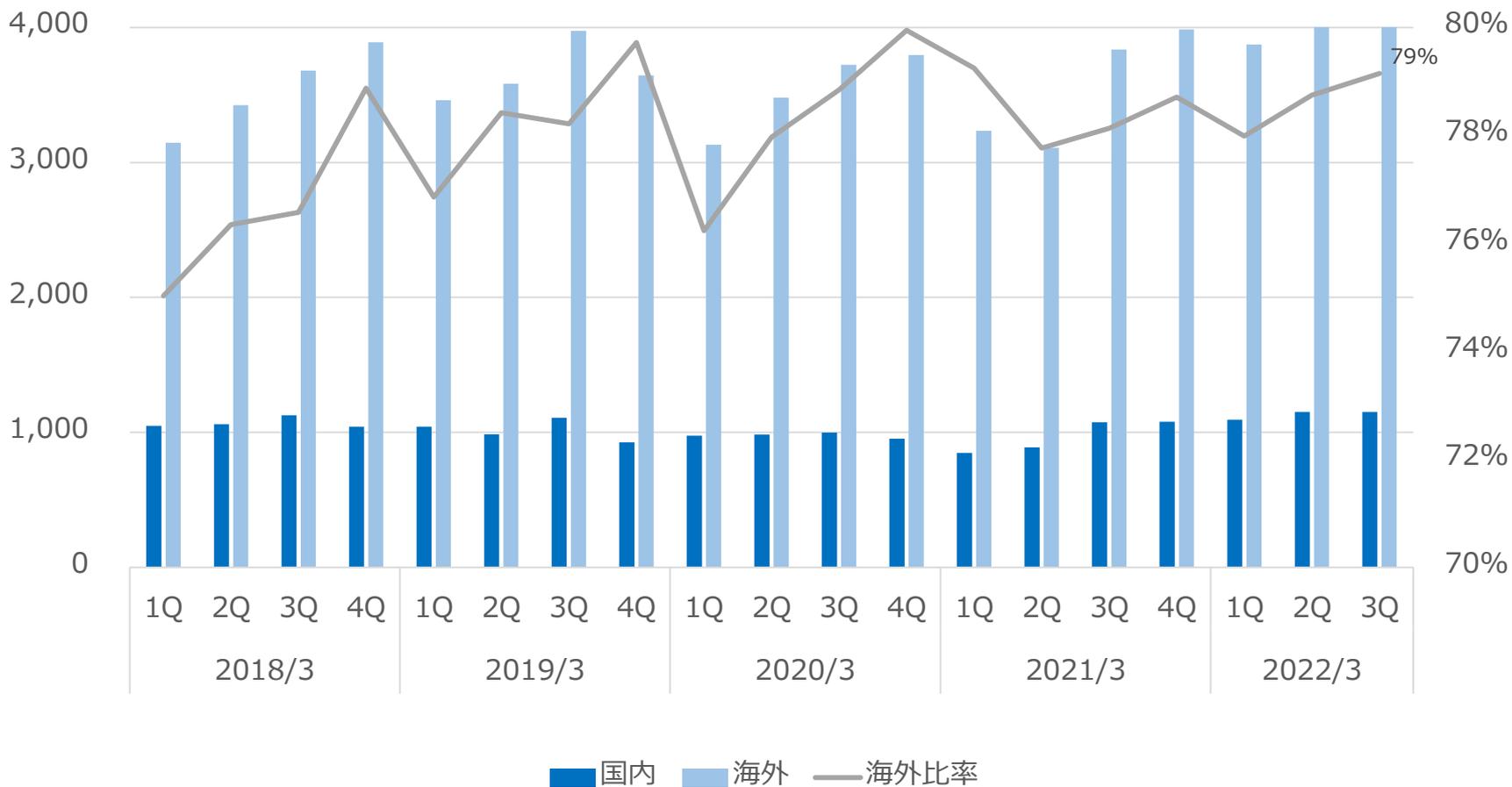
# 2022年3月期3Q累計 連結セグメント業績

(単位：百万円)



# 四半期別 国内外薬品売上高推移

(単位：百万円)



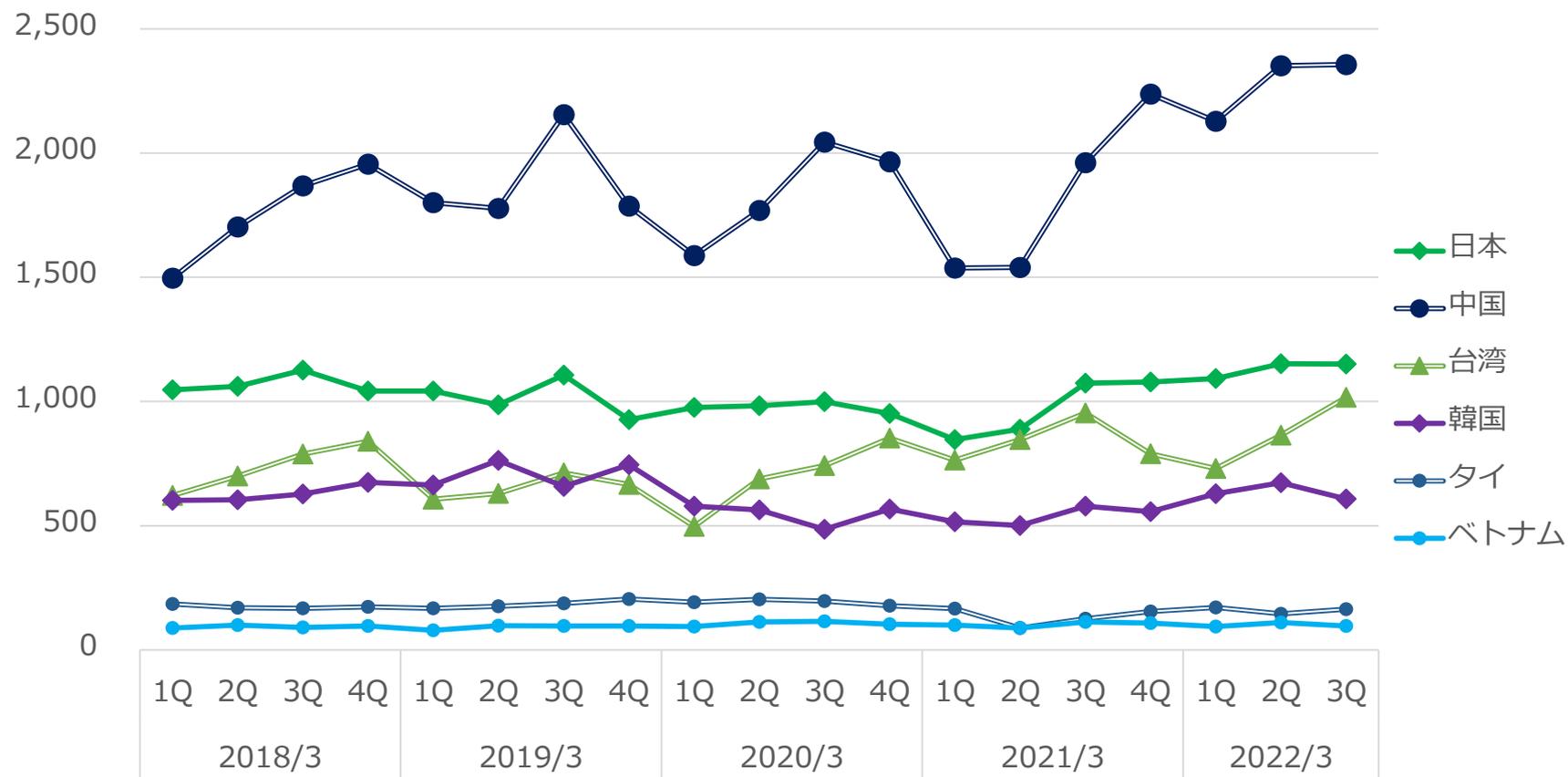
# 四半期別 POP,ビアフィリング用薬品の売上高推移

(単位：百万円)



# 四半期別 地域別薬品売上高の推移

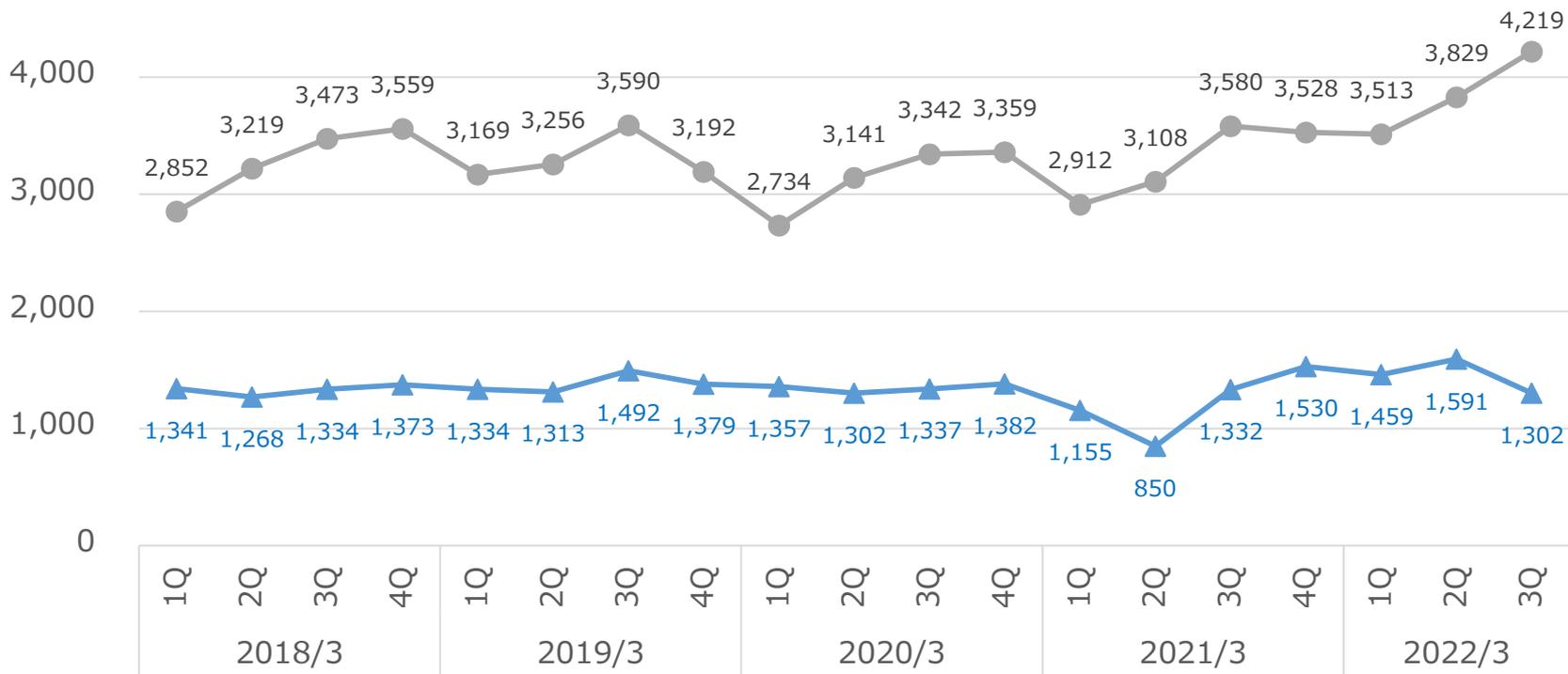
(単位：百万円)



# 四半期別 地域別薬品売上高の推移

(単位：百万円)

## 連結



● 電子薬品

▲ 基幹薬品

電子薬品

QoQ 10%増 YoY 18%増 累計前期比 20%増

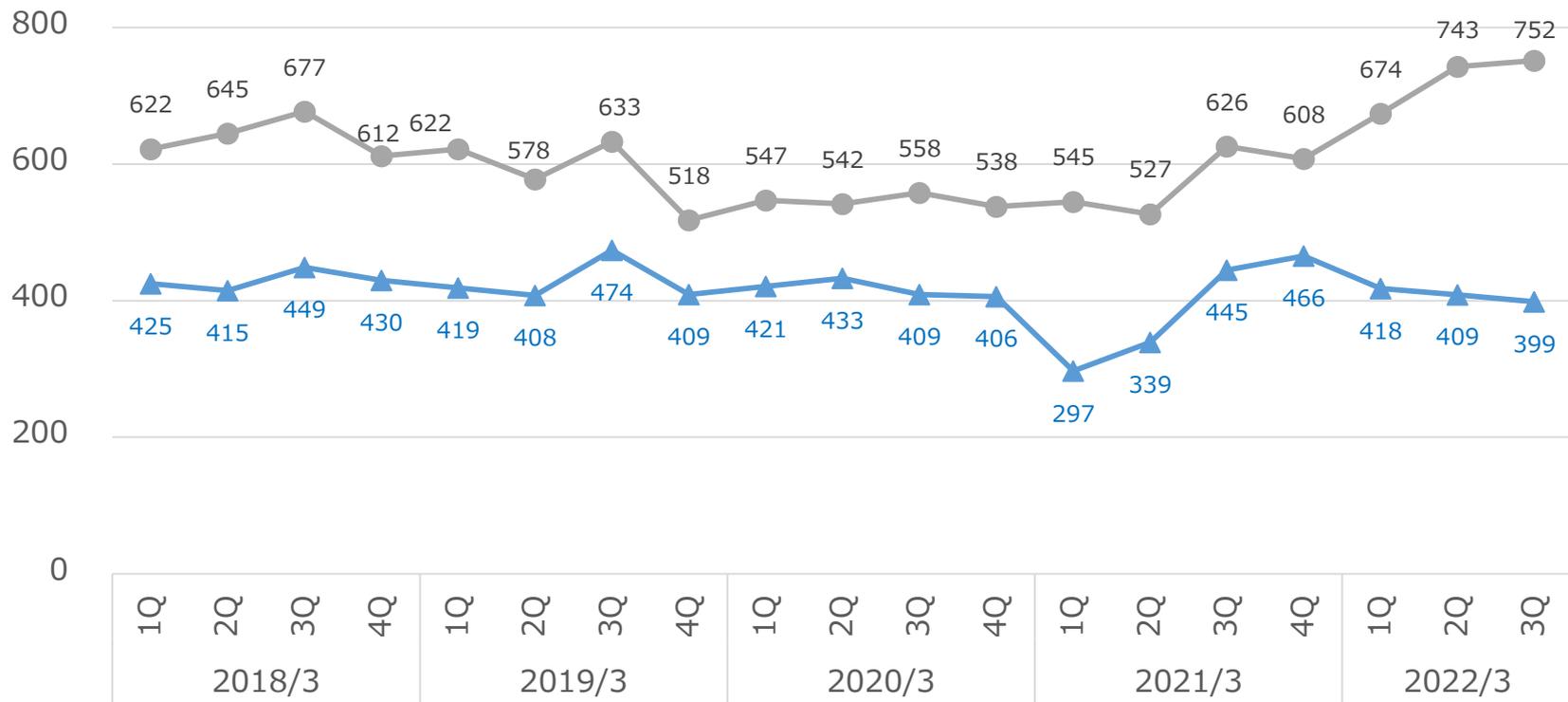
基幹薬品

QoQ 18%減 YoY 2%減 累計前期比 30%増

# 四半期別 地域別薬品売上高の推移

## 国内

(単位：百万円)



● 電子薬品  
▲ 基幹薬品

電子薬品

QoQ 1%増 YoY 20%増 累計前期比 28%増

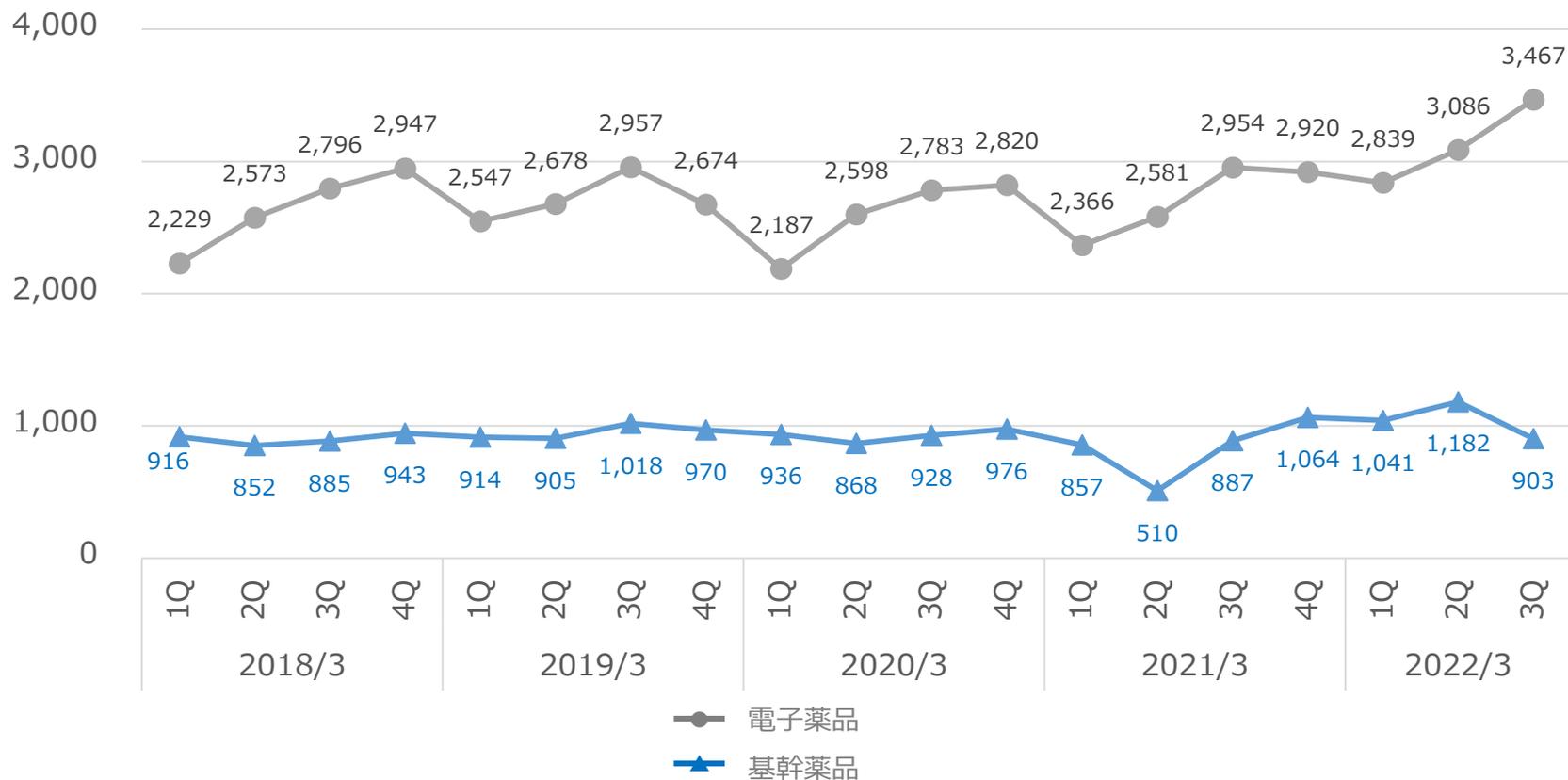
基幹薬品

QoQ 3%減 YoY 10%減 累計前期比 13%増

# 四半期別 地域別薬品売上高の推移

## 海外

(単位：百万円)



● 電子薬品  
▲ 基幹薬品

電子薬品

QoQ 12%増 YoY 17%増 累計前期比 19%増

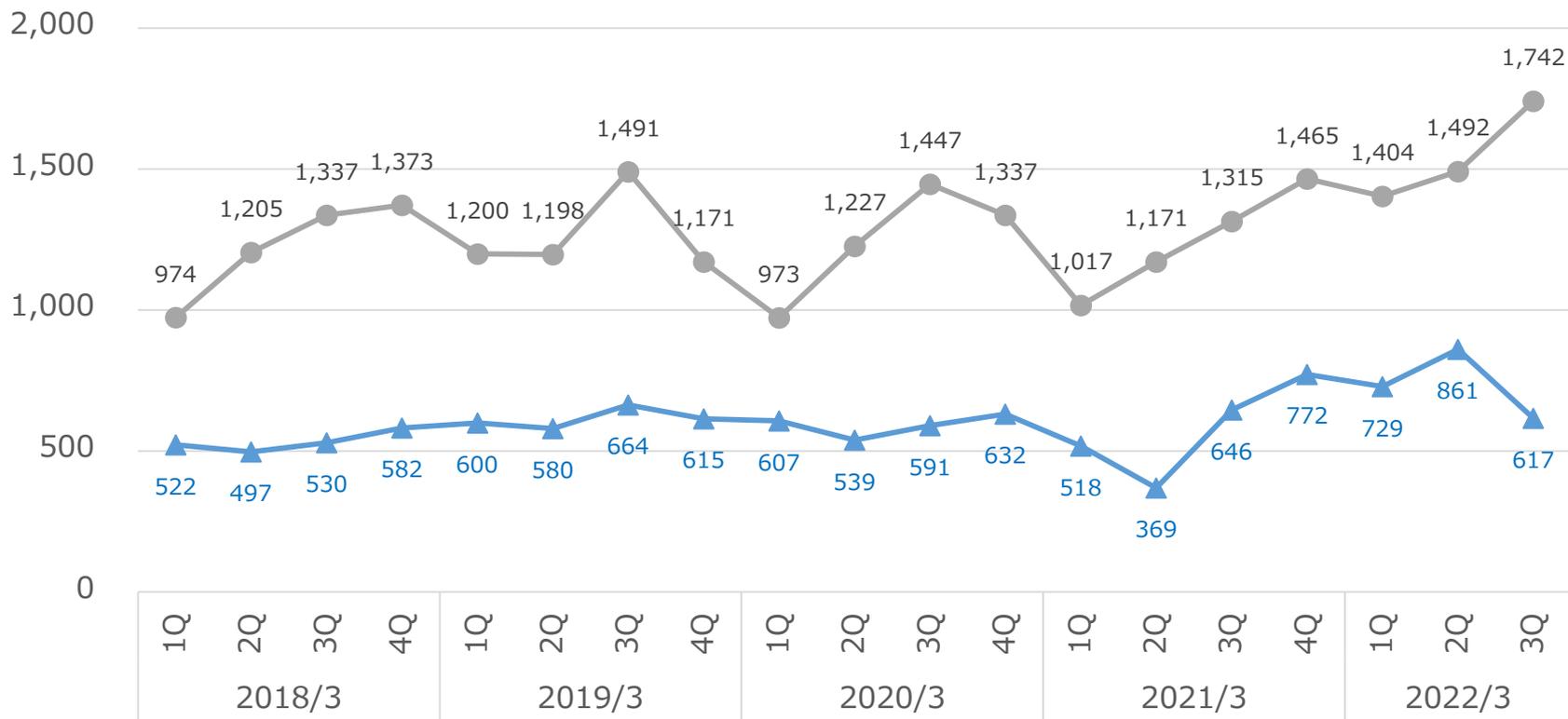
基幹薬品

QoQ 24%減 YoY 2%増 累計前期比 39%増

# 四半期別 地域別薬品売上高の推移

## 中国

(単位：百万円)



● 電子薬品  
▲ 基幹薬品

電子薬品

QoQ 17%増 YoY 32%増 累計前期比 32%増

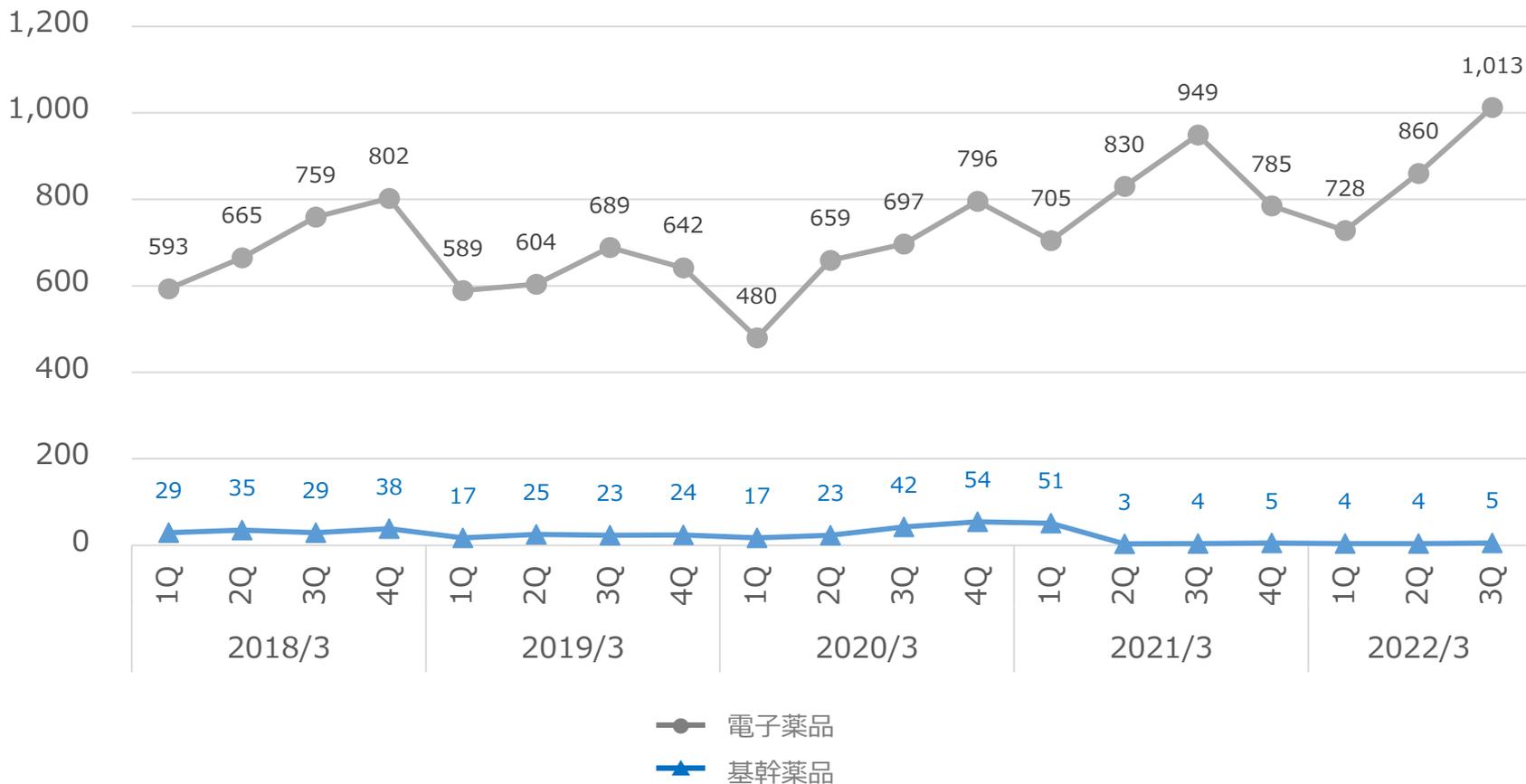
基幹薬品

QoQ 28%減 YoY 5%減 累計前期比 44%増

# 四半期別 地域別薬品売上高の推移

## 台湾

(単位：百万円)



電子薬品

QoQ 18%増 YoY 7%増 累計前期比 5%増

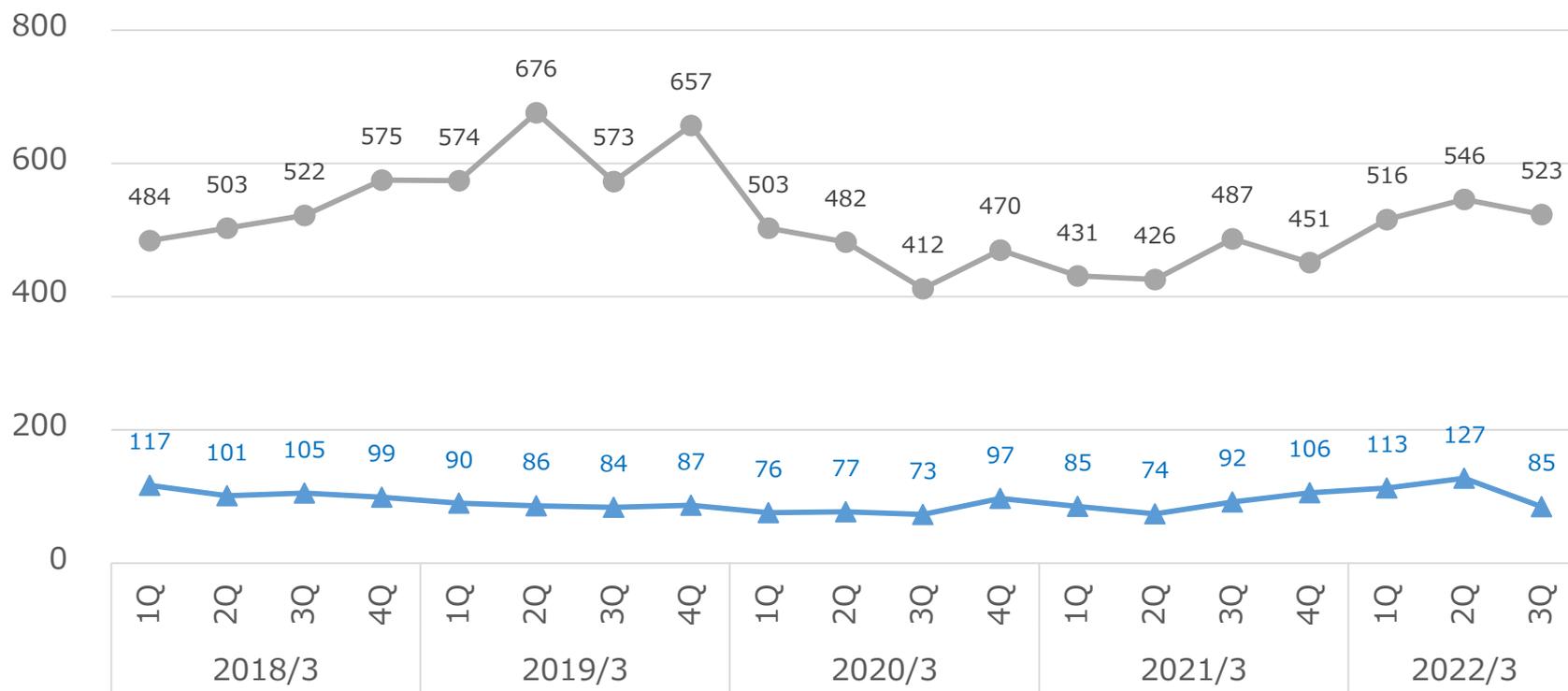
基幹薬品

QoQ 26%増 YoY 9%増 累計前期比 78%減

# 四半期別 地域別薬品売上高の推移

## 韓国

(単位：百万円)



● 電子薬品  
▲ 基幹薬品

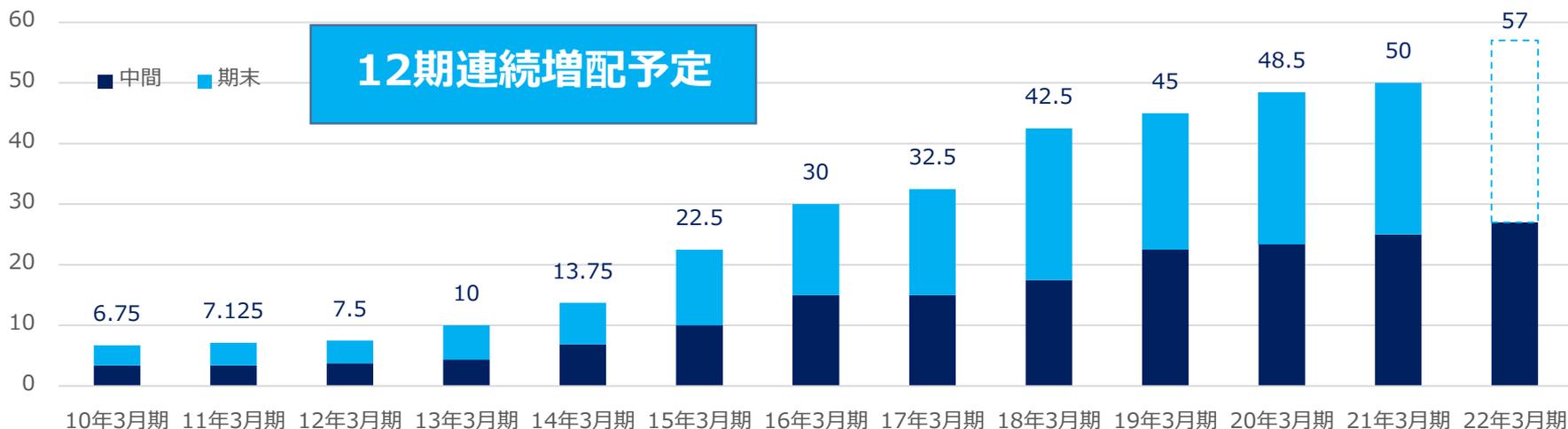
電子薬品  
QoQ 4%減 YoY 7%増 累計前期比 18%増

基幹薬品  
QoQ 33%減 YoY 8%減 累計前期比 29%増

# 配当予想（上方修正）

		2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期 (期首予想)	2022年3月期 (上方修正)
1 株当たり 配当金	中間	23.5円	25.0円	27.0円	27.0円
	期末	25.0円	25.0円	27.0円	30.0円
	年間	48.5円	50.0円	54.0円	57.0円

当社は、持続的な成長を達成するため手元流動性を確保し、安定した財務基盤を維持しつつ、成長投資を継続してまいります。配当は、安定増配基調継続を目指し、機動的な自己株式の取得による株主還元の実施を基本方針としております。



# 参考資料

- 会社概要
- 主な商流
- 主な製品
- 薬品用途説明 最終製品例

# 会社概要

創業 : 1957年 12月

設立 : 1968年 4月 1日

資本金 : 12億4,504万円

年商 : 単体 116億円 連結 220億円 (2021年3月期末)

本社所在地 : 東京都台東区東上野 4-8-1 TIXTOWER UENO 16階

業務内容 : 表面処理薬品、表面処理装置及び関連資材の製造・販売

代表者 : 代表取締役社長兼CEO 木村 昌志

従業員数 : 単体 250名 連結 561名 (2021年3月期末)

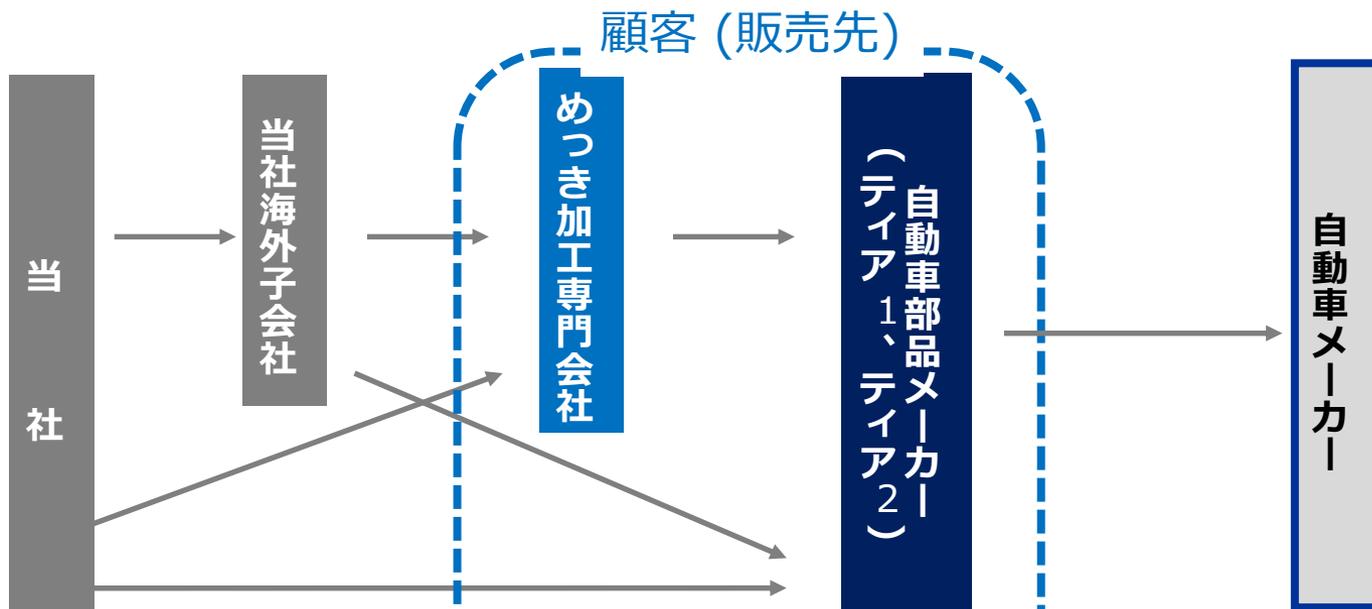
## ISO認証取得

ISO9001 生産本部・本社営業部・総合研究所 JCQA-0281

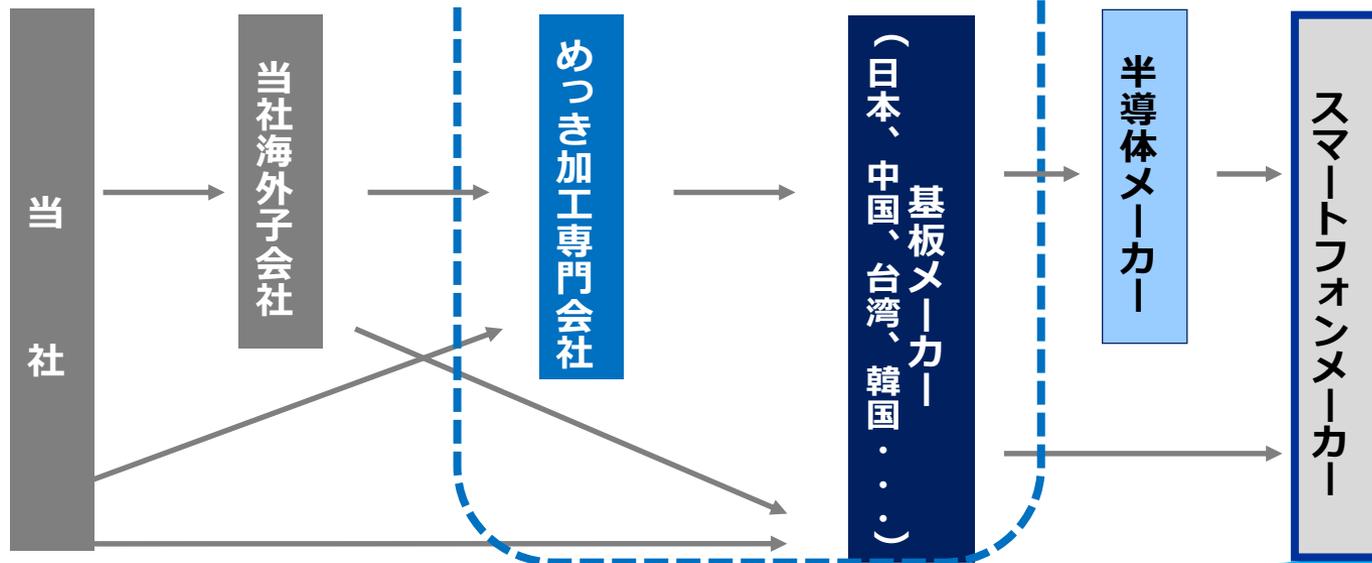
ISO14001 生産本部・総合研究所 JCQA-E-0143

# 主な商流

## 自動車



## スマートフォン



# 主な製品

## 薬品事業

装飾・防錆分野向け (基幹薬品)	自動車部品（フロントグリル、ドアハンドル、エンブレム等） 水栓金具（給水機器、シャワーヘッド、排水栓等） 建築部品（ボルト、ナット等）
電子分野向け (電子薬品)	プリント基板（両面板、多層板、ビルドアップ基板、パッケージ基板等） 電子部品（リードフレーム、チップ部品、コネクタ等） 半導体（シリコンウエハー）

## 装置事業

全自動表面処理装置	素材の投入からめっきの完成まで自動運転をする装置
付帯機器	表面処理装置に付随する、ろ過機等の付帯機器の製造販売
自動分析管理装置	めっき液の濃度を分析し不足分を補給して、自動で管理する装置
プラズマ装置	プリント基板のめっき前処理用等の洗浄処理装置
太陽光発電装置	太陽光発電装置（太陽光パネル）の設置・施工

# 薬品用途説明 最終製品例

用語説明		最終製品
基幹薬品	装飾・防錆分野向け、金属外観の付与、サビ防止などの機能性付与のための表面処理(めっき)薬品。	自動車部品、水栓金具、建築部品
POP薬品 (Plating on Plastics)	基幹薬品の主力製品 プラスチック上へ金属膜をめっきするための薬品 	(自動車部品) フロントグリル、エンブレム など (水栓金具) シャワーヘッド、水栓コック など
その他基幹薬品	銅・鉄鋼などの金属素材へ金属膜をめっきするための薬品	(建築部品) ネジ、蝶番 など
電子薬品	電子信号を流すための回路、電子部品の電気接点などプリント配線板を製造するためのめっき薬品	5G関連部品、データセンター等のインフラ、高機能電子デバイス
ビアフィル薬品 (プリント基板/マザーボード向け)	電子製品に内蔵されるプリント基板/マザーボードに配線を形成するための銅めっき薬品	(5G関連部品) 5G基地局、車載基板、スマート家電 など
ビアフィル薬品 (半導体パッケージ(PKG)基板向け)	半導体チップを外部環境から保護し、プリント基板に実装するための基板(半導体PKG基板)に、配線を形成するための銅めっき薬品	(データセンター等のインフラ) 通信サーバー向けマザーボード など  (高機能電子デバイス) スマートフォン、PC、タブレット、ゲーム機器 など
その他電子薬品	マザーボード、または半導体PKG基板に配線を形成する際、不要な銅を削るためのエッチング薬品 コネクタ、リードフレーム用のめっき薬品など	

この資料には、当社の現在の計画や業績見通しなどが含まれております。それら将来の計画や予想数値などは、現在入手可能な情報をもとに、当社が計画・予測したものであります。実際の業績などは、今後の様々な条件・要素によりこの計画などとは異なる場合があります、この資料はその実現を確約したり、保証するものではありません。

当社ホームページ：  
<https://www.jcu-i.com/>

お問い合わせ先：経営戦略室  
Email： [ir2@jcu-i.com](mailto:ir2@jcu-i.com)  
TEL： 03-6895-7004